

1000万円台で、少量・中量生産用途向け 高品質、全自動書込み装置を提供

Productive(生産性): いかなるプログラミングジョブに対しても容易に管理可能な先進のハンドラシステムとプログラミング技術を提供

Reliability(信頼性): 高品質プログラミング、高成功率および製造許容時間に対応した設計

Affordable(経済性): プログラミング工程の単純化と最小トータルプログラミングコスト、高品質の提供に対応した設計



MICソケットアダプタ

アダプタボードとして、標準タイプに加え中寿命 (Middle Insertion Count) タイプを提供。生産量に合わせて使い分けることで消耗品コストを大幅に削減します。

性能

- 最高2台FlashCOREIIIプログラマ (8ソケット)
- 最高1台LumenXプログラマ (8ソケット)
- 最高700デバイス/時
- 各種マイコン、メモリ、ロジック対応
- 柔軟なメディアI/Oオプション
 - スタティックトレイ
 - 自動トレイフィーダ
 - テープイン/テープアウト
 - チューブイン/アウト

信頼性

- 精密な搬送とアライメント:
 - 専用ピック/プレースヘッド
 - デュアルサポートギヤントリ
 - ビジョンアライメントシステム
- 立証済プログラミング技術
- 高書込み成功率、独自設計高寿命ソケット
- 現地サービス、技術サポートを現地言語にて

効率

- 最小トータルプログラミングコスト(TPC)
- 豊富なデバイスサポート品種
- 既存FlashPAK/FlashCOREアダプタ、アルゴリズムとの完全互換性
- 高品質プログラミング成功率にてスクラップ費用を最小化

■ デバイスハンドリングシステム

- ・製造スループット: 最高700個/時
- ・ブレースメント精度: ±.02mm
- ・ブレースメント力: テップ準拠
- ・ピック/ブレース方法: シングル真空ノズル
- ・プローブ上下ストローク: 50mm最大
- ・位置合わせ: 上視カメラ
- ・準拠規格: CE Compliant、RoHS、WEEE

- ・システムソフトウェア: TaskLink、CH700、Windows10
- ・筐体寸法: 1290mm D x 870mm W x 1520mm H (メディアI/O、モニタ含まず)
- ・梱包寸法: 1310mm D x 930mm W x 1760mm H (メディアI/O、モニタ含まず)
- ・本体重量: 450Kg (梱包重量: 550Kg)
- ・対応デバイスパッケージサイズ範囲(2mm x 3mm ~ 42.5mm x 42.5mm)

■ I/O メディアオプション

- ・テープイン: 12mm - 56 mm テープ幅対応
- ・テープアウト: 8mm - 44 mm テープ幅対応 (可変)
- ・トレイフィーダ: 最高20枚 JEDEC トレイ対応
- ・マニュアルトレイ: 特別なツール不要
- ・チューブイン
- ・排出ピン

■ 付加価値ソフトウェア

- ・オートモーティブパフォーマンスパック
- ・NNADフラッシュバッドブロック管理
- ・シリアル番号サーバイバー
- ・ConneXサービスソフトウェア
- ・LumenX専用
- ・UFS用VerifyBoost
- ・コマンドラインインターフェース

■ デバイスマーキングオプション(装置購入時のみ選択可能)

- ・ファイバレーザマーカ: >1mm x 1mm
- ・電力: 1-10W
- ・インクドットマーカ、対象デバイスサイズ: >4mm x 4mm (*テープアウト使用時のみ使用可能)

■ 追加オプション

- ・2Dテープアウト検査
- ・内蔵イオナイザ
- ・バーコードスキャナー

注)レーザー刻印の深さはパッケージの材質により異なります。出力を20%に設定した場合の深さは150μm(代表値)となります。詳細は問合せ願います。

■ プログラミングエンジン、アダプタ/デバイスサポート プログラマ

- ・FlashCORE III(8ソケット)
- ・LumenX(8ソケット)

ソケット技術

- ・標準ソケットアダプタ(一般バーンインソケット使用、ソケットあたり5,000-10,000回挿抜推奨)
- ・MIC(中寿命)ソケットアダプタ: BGA,QFN,QFP,SOP(ソケットあたり50,000回挿抜推奨)
- ・HIC(高寿命)ソケットアダプタ: BGA,TSOP,QFP(ソケットあたり250,000回挿抜推奨)

パッケージサポート

- ・PLCC, SO, SOIC, TSOP, TSSOP, SSOP, BGA, CSP, MLP, QFN, MLF, LAP,QFP, TQFP, PoP, DIP他

■ サポートオプション/サービススペア

- ・PSV3500 基本スペアキット
- ・PSV用 補助スペアキット
- ・運用トレーニング
- ・サポート/サービス契約:
 - ・ハードウェア無償修理契約(消耗品、機械部品除く)
 - ・ソフトウェア/アルゴリズム保守/追加サポート受付契約
 - ・現地定期検査/整備、修理作業年間契約

ユニバーサルデバイスサポート

- ・FlashCOREIII: Flashメモリ(NOR, MCP, eMMC, SD, MoviNAND, OneNAND, iNAND, シリアルフラッシュ, EEPROM, EPROM...), MCUおよびロジックデバイス (CPLD, FPGA, PLD)
- ・LumenX: eMMC, UFS, SD, MCU, SPI NOR

デバイス書込みと試験

Program(書込み)、コンティニューイティ(導通試験)、チェックサム、ブランクチェック、挿入誤り、テスト、Verify(ベリファイ)、ひっくり返し、2パスベリファイ、IDチェック、イリーガルビットチェック

■ システム要件

- ・入力電圧・電流: 208-240VAC、50/60Hz、単相、10A (最大)
- ・運用時温度: 13°C - 30°C
- ・湿度: 35% to 90% RH,非結露
- ・エア圧: 80 psi (5.5Bar)
- ・エア流量: 6 SCFM (最大)

Data I/O製品顧客

主要なグローバルオートモーティブ企業で電子制御ユニットとブレーキシステムに正しくプログラミングするData I/Oを採用しています。工業制御、医療、防衛関連企業も同様です。トップワイヤレスハンドセット企業も毎年数百万台の製品プログラミングのソリューションとしてData I/Oを使用しています。